



3D-MID Leiterplatten: Zukunftsvision oder Realität?

Mit 3D-MID wird das Portfolio der 3D- bzw. 2,5D-Leiterplatten-Technologien um Möglichkeiten ergänzt, die im Gesamtsystem kostengünstig realisierbar sind.

MEMS schlägt Quarz im Auto

Die MEMS-Technik bietet eine dem Quarz überlegene Timing-Präzision für die Automobilelektronik.

Energieeffizienz in Batteriesystemen

Ladearchitekturen und innovative Beispiele für Ladegeräte mit effizienter Energiewandlung.

Push-X für die Leiterplatte

Die Weiterentwicklung von Push-in und Hebel-Push-in für den schnellen PCB-Direktanschluss.

Unsere
Komponenten
bringen Sie sicher
ans Ziel

DigiKey

Einzelheiten
auf der
Innenseite.